

# Fuzion XC2-37



## 重新界定生产能力 从新品导入至大量生产均可轻松应对

### Fuzion XC2-37平台

环球仪器的Fuzion™平台是现代贴片平台的一个革命性创举，能让各电子生产厂家在提升生产力至最高水平的同时，实现成本下降。Fuzion™系列平台配备的送料器数量，超过传统贴片机两倍以上，大大减少换线的需要及提高平台使用率。

在Fuzion系列平台中，Fuzion XC2-37™是一个通用性极强的平台，只需一个设备，已足以应付高速贴片，以至异型元件贴装。

Fuzion XC2-37能贴装大板，以及不同尺寸的元件，无论是作为新品导入、一体化设备、生产线平衡机或多功能机，它均是不二之选。

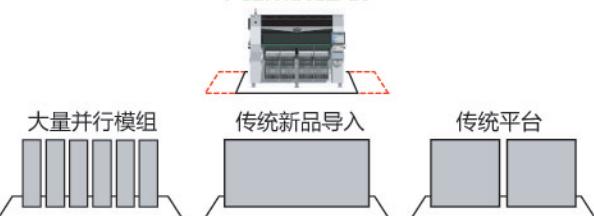
### Fuzion XC2-37优势

- 重新界定生产能力 – 送料器站位为传统平台的两倍
- 充分利用生产设备及提高效率 – 令新品导入更流畅，减少换线
- 高度灵活的一体化设备 – 在不能确定产品特性的环境下，可以接受任何生产订单
- 最低的购置成本 – 可以减低资本投入及生产成本
- 充分发挥厂房面积使用率 – 一台具有更多送料器站位的Fuzion平台能取代多个模组

### 重新界定生产能力

- 比同类方案拥有双倍的8毫米及盘式送料器站位
- 一台具有更多送料器站位的Fuzion平台能取代多个模组
- 业界送料器站位密度最高，平均每个送料器站位的成本最低

#### Fuzion XC2-37



### 新品导入方案

可以应对特大电路板、从极大至极小的元件，具备更多送料器站位，可以轻轻松松把产品转到大批量生产线



### 高度灵活的一体化方案

性能表现绝对有保证，单一平台上已可以独立生产多种不同的产品，在电路板尺寸、送料器站位数量或元件尺寸范围方面，几乎可以说是不设上下限



### 灵活的生产线平衡方案

可以协助上线或下线机器的贴装工序，解决生产线瓶颈问题，令生产线更流畅及提高产能



### 高速生产线上时泛用机方案

采用双悬臂的贴装平台，以高速的FZ30™及高精灵活的FZ7™贴装头来应对业界整个元件/封装范围



### 充分利用生产设备及提高效率

- 厂家的设备使用率一向偏低
- Fuzion方案送料器站位为其他平台的两倍，可以将平台使用率提升50%，大大提升产能 – 足以令电子生产厂家减少一个生产班次
- 在同一个平台上，可以设置多种产品的生产，去除换线工序
- 固定设置针对同一产品系列
- 可以采用“一料多站”或“替补供料”模式设置送料器站位
- 可以在平台上任意放置生产所需的送料器 – 非常灵活的送料器站位设置
- 不同贴装头间，拥有最大的重叠贴装范围
- 可以在新品导入模式或在飞行中进行参数调整，加快进入大量生产环境
- 灵活、容易上料、可连续接料的送料器，减少补充送料器及换线时间



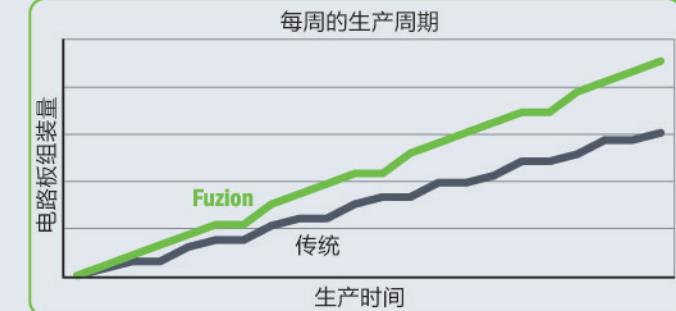
### 定位系统

Fuzion XC2-37平台建立在环球仪器所有贴片机平台的成功基础上，采用专利的VRM线性马达技术，精度高达1微米分辨率，加速度高达2.5G，采用双驱动架构减少稳定时间。Fuzion平台的VRM线性马达技术，备有5年保用期。



### 贴装头技术

Fuzion XC2-37备有高速及灵活的贴装头，贴装头间的重叠贴装范围甚广，提高使用效率。



### 高度灵活的一体化设备

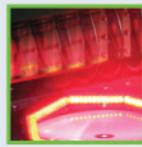
- 在不能确定生产特性的环境中可以接受任何产品的生产
- 在单一平台上进行试产，然后可以轻轻松松地转入大量生产
- 可以应对范围甚广的元件、封装类型及电路板尺寸
- 应对任何尺寸的电路板 -- 最大为1300毫米 X 610毫米 (51寸X 24寸)
- 应对任何元件 – 在同一平台上，可贴装01005无源器件至150毫米长的连接器，不同贴装头间的重叠贴装范围大，无需换头，无需留有备用贴装头/悬臂，所以不需额外的资本投资
- 可以运用5千克的贴装压力和贴装高达25毫米的元件
- 可以自动更换适合异型元件的吸嘴
- 可以采用任何类型的送料器–条状带式、带式、管式、异型元件式或盘式，自动盘式送料器不占用机器的料站空间



### 视觉系统

FZ30贴装头备有两个放置在头上视觉系统，可以在飞行中拍摄整个系列元件，由01005无源器件至30平方毫米的元件。

- 窄小视野范围的相机识别01005至12毫米平方的元件
- 可以调整至较宽阔的视野范围以拍摄最大达30毫米平方的元件
- 可以拍摄无引脚、有引脚、球状及异型元件
- 镜头上备有垂直元件感应器，以确保元件到位/方位正确



### FZ7贴装头视觉系统

- 采用数码CCD特大像素技术，在最大的视野范围内，可以拍摄最精细的影像
- 三种不同的型号，可以应对大范围的应用
- 三个不同角度的照明，以八级增量独立调控，或统一始用

### 最低的购置成本

- 减少资本投资额及整体生产成本
- 较同类方案可采用更少模组
- 所需要的的操作员数量、培训成本、维护成本、电力/压缩空气用量、编程及劳动/维修成本更低

### 通用的周边设施

- 所有Advantis 3、Genesis系列II、甚至更早的平台的周边设施，全部均适用于 Fuzion XC2-37平台。

### Fuzion XC2-37技术参数

贴片速度(cph(秒/元件))	最高	43,000 (0.084)
	1-Bd IPC晶片(1608)	20,500 (0.176)
精度(微米@1.33 Cpk/1.00 Cpk)	晶片	±55/±41
	集成电路	±45/±34
电路板尺寸(毫米(英寸))	最大(宽x长)	610 x 1300 <sup>1</sup> (24 x 51)
	最小(宽x长x高)	50.8 x 50.8 x 0.508 (2 x 2 x 0.02)
元件范围(毫米(英寸))	最高重量(千克(磅))	5.0 (11.0)
	最大(宽x长x高)	150 x 150 x 30 <sup>2</sup> (5.91 x 5.91 x 1.18)
机器尺寸(毫米(英寸))	最小(宽x长x高)	0.18 x 0.38 x 0.10 (0.007 x 0.015 x 0.004)
	(长x深x高)	2385 x 2160 x 1930 (93.90 x 85.04 x 75.90)
送料器站位	多达272个8毫米站位–类型：	带式、条状带式、盘式、管式、异型元件式

<sup>1</sup>须使用长板工具选项

<sup>2</sup>请翻阅机器规格说明书查询贴装元件规格